

第2回

# 3次元積層 半導体量子イメージセンサ 研究会

2018

1/29月

13:30-17:30

KEK

AIST

東京大学  
VDEC

筑波大学

参加費  
無料  
定員150名

## 招待講演

### 3次元集積化技術の現状と将来展望

東北大学 小柳 光正氏

### 画素並列信号処理 3次元構造イメージセンサの研究開発

NHK放送技術研究所 後藤 正英氏

### 3Dパッケージロードマップと実現への挑戦課題

株式会社SBRテクノロジー 西尾 俊彦氏

### Cryo-SOI 極低温集積回路と Ge:Ga遠赤外線検知器を用いた 3D積層遠赤外線イメージセンサーの開発

JAXA/宇宙科学研 和田 武彦氏

### 3次元積層プロセスに向けた インタラクティブ検証環境の構築

北海道大学 大学院情報科学研究科 池辺 将之氏

## 一般講演

### 新井 康夫氏 (KEK)、菊地 克弥氏 (産総研)

## お問い合わせ

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構  
素粒子原子核研究所 新井康夫 mail: yasuo.arai@kek.jp

## 会場

つくば国際会議場  
(中会議室202室)

## 詳細・参加申込



会場準備の都合上、  
できるだけ事前申込みをお願いします。

詳細はサイトを  
ご覧ください

[http://rd.kek.jp/  
project/soi/TIA18/  
1801\\_TIA3D.html](http://rd.kek.jp/project/soi/TIA18/1801_TIA3D.html)



## 第2回

# 3次元積層半導体量子イメージセンサ研究会

### program

13:30 はじめに

高エネルギー加速器研究機構 新井 康夫

一般講演

13:40 「産総研 3次元積層技術(仮題)」

産業技術総合研究所 菊地 克弥

招待講演

14:10 「3次元集積化技術の現状と将来展望」

東北大学 小柳 光正

14:40 「画素並列信号処理 3次元構造イメージセンサの研究開発」

NHK放送技術研究所 後藤 正英

15:10 Coffee Break

招待講演

15:30 「3D パッケージロードマップと実現への挑戦課題」

株式会社 SBR テクノロジー 西尾 俊彦

16:00 「Cryo-SOI 極低温集積回路と Ge:Ga 遠赤外線検知器を用いた  
3D 積層遠赤外線イメージセンサーの開発」

JAXA/宇宙科学研 和田 武彦

16:30 「3次元積層プロセスに向けたインタラクティブ検証環境の構築」

北海道大学 大学院情報科学研究科 池辺 将之

17:00 まとめ・議論

#### 会場

つくば国際会議場 (エポカルつくば)  
〒305-0032 茨城県つくば市竹園 2-20-3  
URL: <http://www.epochal.or.jp/>

#### アクセス

つくばエクスプレス つくば駅より徒歩 10分  
会場周辺に有料駐車場あり  
<http://www.epochal.or.jp/access/index.html>

